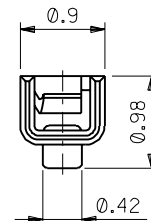
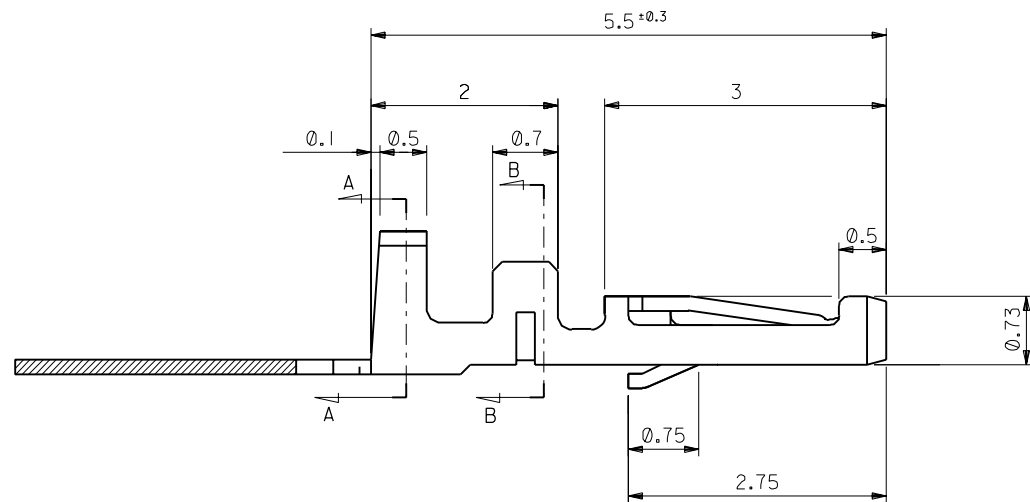
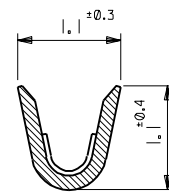
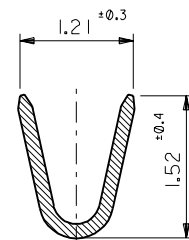
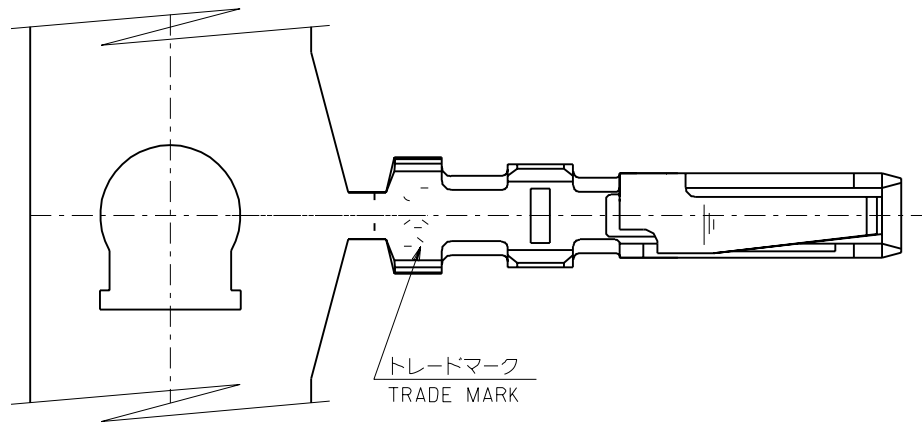


DWG. NO. SD-50641-8***



注記
NOTES

- 適合ハウジング：51146シリーズ
APPLICABLE HOUSING：51146 SERIES
- メッキ仕様 (PLATING)
金メッキ：0.2*μmMIN. ニッケル下地：1.5*μmMIN.
Au：0.2*μmMIN. Ni(UNDER PLATE)：1.5*μmMIN.

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30°以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISD (JC70448)	S.M. Y.M	'96/11/3
10°以上 30°未満 UNDER	+0.25	A	変更 REVISD (JC60814)	S.M. Y.M	'96/8/21
10°未満 UNDER	+0.2	Q	新規作成 PROPOSED (JC60420)	Y.M. H.H	'95/12/25

材料 MATERIAL	リン青銅 (t=0.15) PHOSPHOR BRONZE
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	#28 ~ #30
被覆外径 INS. RANGE	φ0.5 - 0.9
DRAWN BY '95/12/25	CHK'D BY '96/11/5
Y. MIZUNO	Y. MIZUNO
APP'D BY '96/11/5	尺度 SCALE 20:1
M. FUKUSHIMA	

50641-8141	バラ状 LOOSE
50641-8041	連鎖状 CHAIN
ENG. NO.	端子形状 FORM

molex MOLEX-JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
I.25 WIRE TO BOARD CONN. CRIMP RECEPTACLE	
DWG. NO.	REV
SD-50641-8***	C